

成蹊大学理工学部理工学科 教員公募

1. 職位
大学教授または大学准教授または大学講師
2. 採用予定人数
1名
3. 専門分野
インダストリアルエンジニアリングを中心とした広い意味での経営工学分野
4. 業務内容
 - (1) 研究
 - (2) 学部・大学院教育
 - (3) 研究室学生に対する教育・研究指導
 - (4) その他、学部運営業務等
5. 担当予定科目
 - ・ 講義科目： 機械システム専攻の科目（インダストリアルエンジニアリング、経済性工学Ⅰ・Ⅱなど）、学部共通科目（アカデミックスキルズⅠなど）、大学院専門科目など
 - ・ 実験・演習科目：機械工学実験、PBLⅠ・Ⅱ、輪講、卒業研究など
6. 応募資格
 - (1) 博士の学位を有すること（着任時において取得見込みを含む）
 - (2) 専門分野に知識と経験を有し、教育・研究に熱意を持って取り組める方
 - (3) 大学運営に関連する諸業務に積極的に取り組める方
7. 着任時期
 - ・ 採用予定日： 2024年4月1日（月）
 - ・ 契約期間： 期間の定めなし（定年制あり）
 - ・ 試用期間： 試用期間なし
8. 就業場所
 - ・ 名称： 成蹊大学
 - ・ 所属： 理工学部 理工学科
 - ・ 所在地： 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1
 - ・ URL： <https://www.seikei.ac.jp/university/>
9. 待遇
 - ・ 賃金：
 - (1) 基本賃金（月給）： 成蹊学園の規定により支給する（経歴等を勘案し決定する）
 - (2) 通勤交通費： 通勤距離が片道2km以上の場合に限り、4月と10月の給与支給日に6ヶ月定期券相当額（上限300,000円）を支給する
 - (3) 諸手当： 家族手当、住宅手当、超過授業手当など
 - (4) 賃金支払日： 毎月20日
 - (5) 支払方法： 所定銀行口座への振込による
 - (6) 賃金支払い時の控除： 有（所得税、住民税、社会保険料）

- (7) 昇給：有
- (8) 賞与：有（学園の財政及び勤務成績に応じて支給する）
- (9) 退職金：有

- ・ 各種社会保険：
 - 社会保険の加入：三菱健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団
 - 雇用保険の適用：有
 - 労災保険の適用：有
- ・ 福利厚生：
 - 財形制度（一般・住宅・年金）、私学共済・三菱健康保険組合の各種福祉事業など

10. 応募書類

- (1) 履歴書（氏名、連絡先、学歴、職歴、学会及び社会における活動等、写真を貼付）
 - (2) 研究業績等のリスト（学術論文：査読付き論文とその他の論文を区別、国際学会発表、受賞、競争的資金獲得状況、研究業績が分かるリンク先(Google Scholar あるいは Research Gate 等)、その他特記すべき事項）
 - (3) 主要論文の別刷り（コピー可、5編以内）
 - (4) これまでの研究概要（任意形式でA4版、1ページ程度）
 - (5) 教育歴のある方はその概要（任意の形式でA4判1ページ程度）
 - (6) 今後の研究計画と教育に対する抱負（任意形式でA4版、1ページ程度）
 - (7) 応募者について所見を得られる方2名の氏名と連絡先
- ※ 書類に不備がある場合には選考から除外されることがあります。
 - ※ 選考過程において、推薦状1通をご提出いただきますのでご承知おきください。
（自己推薦不可。応募書類（7）に係る2名と重複可。任意形式。）
 - ※ 応募書類は返却いたしません、応募者の情報管理は適切に行います。

11. 応募締切

2023年9月29日（金）（必着）

12. 書類提出先および問い合わせ先

〒180-8633

東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

成蹊大学理工学部理工学科 教授 小方博之

TEL: 0422-37-3708(直通)

E-mail: ogata(at)st.seikei.ac.jp（注: (at)を@に変えてください）

13. 書類提出方法

封書に「経営工学分野 専任教員募集書類在中」と朱書きし、簡易書留で上記の宛先まで送付してください。

14. 選考方法

書類選考及び面接（2023年10月21日（土）あるいは22日（日））を行います。

- ※ 書類選考通過者には、面接のご案内を送付します。ただし、面接に際しての旅費交通費、宿泊費等は自己負担となりますので御了承ください。